

**通过技术与对话，创造未来**

**Technology & Tai-wa** for Tomorrow

**Corporate Profile**

# KOKUSAI ELECTRIC Way

我们不断追求技术。

在各领域中打磨技术并将其融合，以此进行创新。

我们始终重视对话。

真诚地保持对话，真挚地面对课题本质，  
以此寻找最佳解决方案。

我们将继续通过技术与对话满足多样化的需求，  
为不断涌现创造和革新的未来持续提供支持。

## 2022年更新企业理念

通过连续的创造和革新，将世界各地所描绘的各种梦想逐一实现，打造美好未来。

我们希望成为世界上的最佳合作伙伴，决心今后继续通过技术和对话来支持未来发展，因此将企业理念更新为“KOKUSAI ELECTRIC Way”。

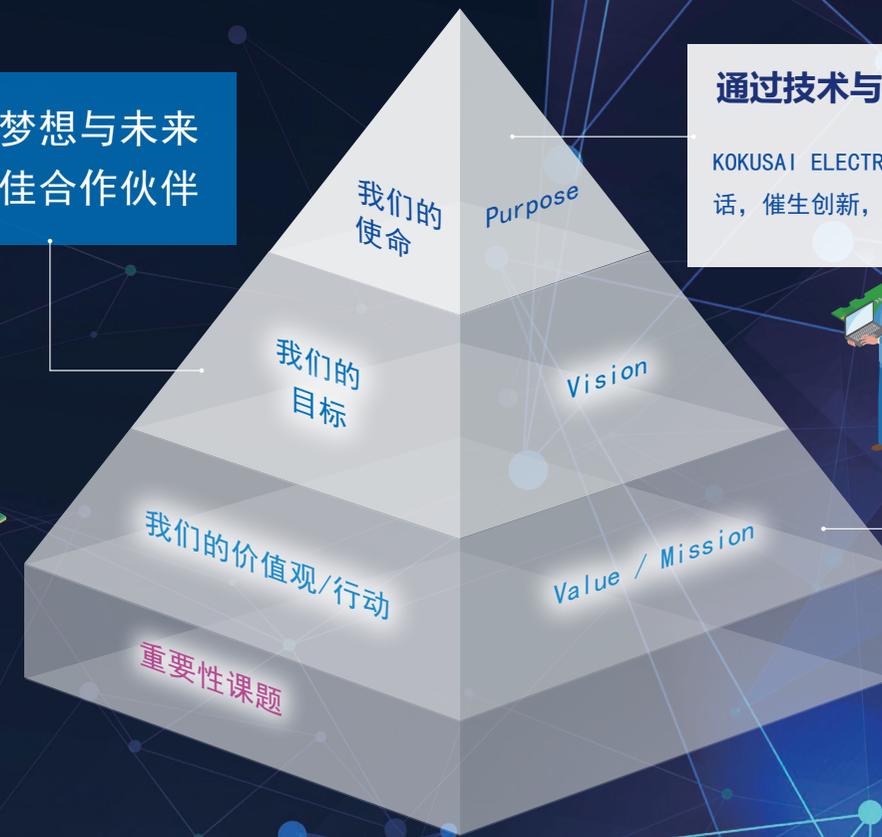
在制定过程中，员工组成了工作组，从回顾我们的存在意义、必须履行的使命、重要的价值观等开始，开展了多次讨论。

我们的技术和对话是持续成长路上不变DNA，今后也要将这种珍贵的精神传承给子孙后代。

连接梦想与未来的  
最佳合作伙伴

通过技术与对话，创造未来

KOKUSAI ELECTRIC集团通过技术与对话，催生创新，成就未来。



## 我们的技术

- 磨砺技术
- 以技术迎接挑战
- 创新技术
- 展现技术的魅力

## 我们的对话

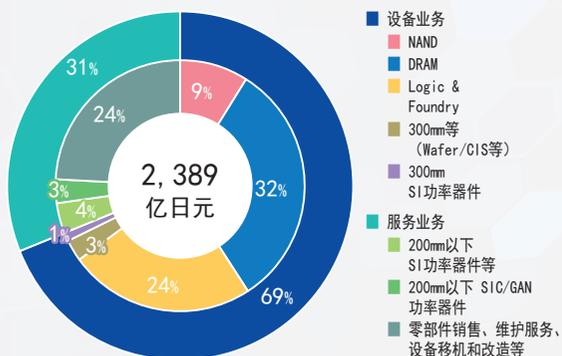
- 与先进技术的对话
- 与社会课题的对话
- 与自然环境的对话
- 与自身的对话

# At a Glance

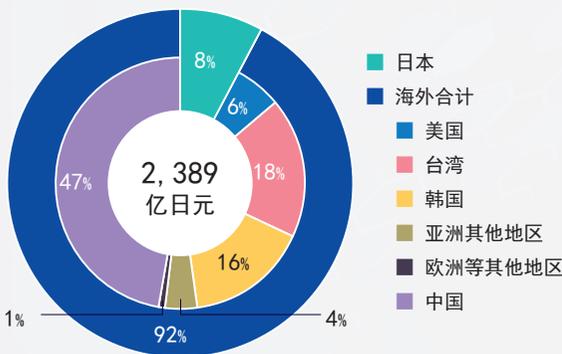
在半导体制造涉及的众多工艺中,本集团开展的事业主要集中于成膜工艺、膜质优化处理工艺、氧化·扩散·退火工艺,这些工艺决定了半导体器件的性能。本集团的半导体制造设备为这些工艺技术提供支持,受到了世界各地半导体器件制造商的高度评价,占据了全球最高市场份额。

## 财务概况

2025年3月期的各业务/  
应用程序划分的销售额收益(合并)

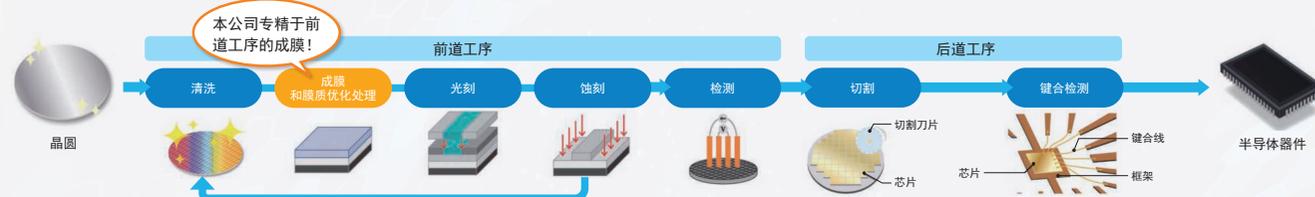


2025年3月期的各地区(各收货地)销售额收益(合并)



## 业务内容(设备业务)

本集团研发了在半导体器件制造工序的“前道工序”中,主要决定器件性能的成膜工艺设备和单片式膜质优化处理工艺设备。成膜工艺是在晶圆上形成薄膜(该薄膜将会成为电路材料)等的工艺,而膜质优化处理工艺是提高在成膜工艺中形成的薄膜质量的工序。未来的器件将会变得更加复杂化、小型化、三维化,因此本集团的成膜技术和膜质优化处理技术将变得越来越重要。



### 批量成膜设备

批量ALD\*成膜设备

全球市场占有率 No. 1 (2024年)\*2

- 在批量处理超过数十片晶圆的批量成膜设备中,可支持ALD技术的设备。可同时实现高难度成膜和高生产效率。
- 随着器件的复杂化,需求正在不断扩大。



### 膜质优化处理设备

Plasma Gate Modification Tools

全球市场占有率 No. 1 (2024年)\*3

- 旨在成膜后通过等离子体或加热来优化膜质的设备。采用独有的等离子体技术,实现出色的各向同性和台阶覆盖率。
- 随着器件的复杂化,需求正在不断扩大。
- 低温环境中的膜质改善需求也在增长。



## 业务内容(服务业务)

提供本公司制造和销售的半导体制造设备在整个生命周期的售后服务,包括零部件销售、维护服务、有偿维修、设备移机和改造。此外,利用集团公司的销售网络,重点销售晶圆尺寸200mm以下的传统设备(全新和二手),秉持“Design for Service Business”的理念,努力提供具备更高附加价值的服务。



\*1 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

\*2 出自:TechInsights Inc. “TI ALD Tools\_YEARLY”(April 2025)

\*3 出自:Gartner® Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al. Published 21 April 2025. Revenue share from Shipments basis of Plasma Gate Modification Tools in CY2024. GARTNER是Gartner Inc.或其关联公司在美国和其他国家(地区)的注册商标和服务标志,我们经该公司许可后使用。All rights reserved. Gartner不为Gartner研究出版物中的任何特定供应商、产品或服务背书,它并非旨在建议技术用户只选择获得最高评级或其他评级的供应商。Gartner Research出版物是发表Gartner Research的见解,并非表述事实。无论明示或暗示,包括本研究的商品性以及对于特定目的的适用性在内,Gartner概不负责。本书中记载的Gartner的内容(以下简称“Gartner内容”)作为Gartner财团订阅服务的一部分,是表述由Gartner, Inc.(以下简称“Gartner”)发行的研究观点或见解,并非表述事实。Gartner内容中的内容均为该Gartner内容发行时的内容,并非本书发行之日的内容。此外,Gartner内容中记载的见解可能会在未经预告的情况下发生变更。

# 全球网络

日本国内

海外

海外员工比例(合并)\*

各地区员工比例(合并)\*

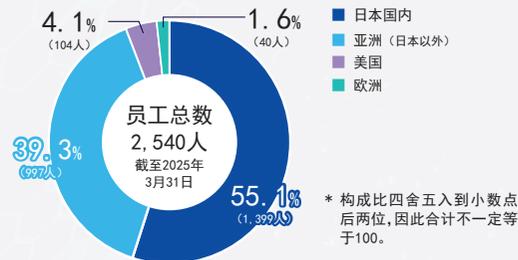
主要研发、设计、生产基地

2家

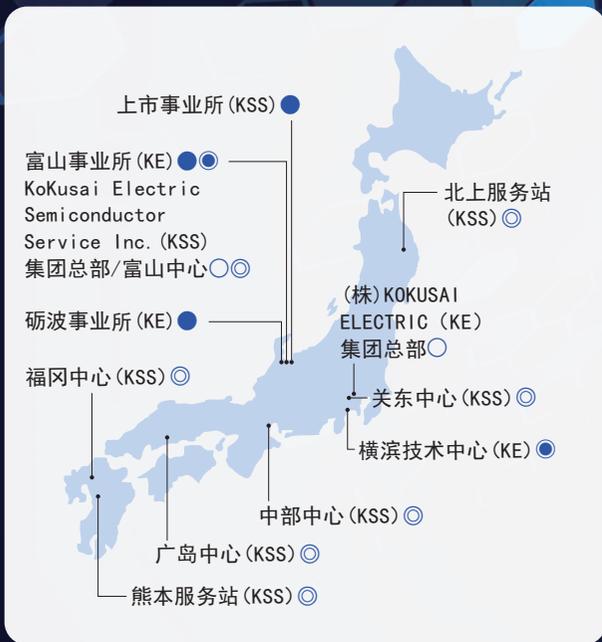
6家

44.9%

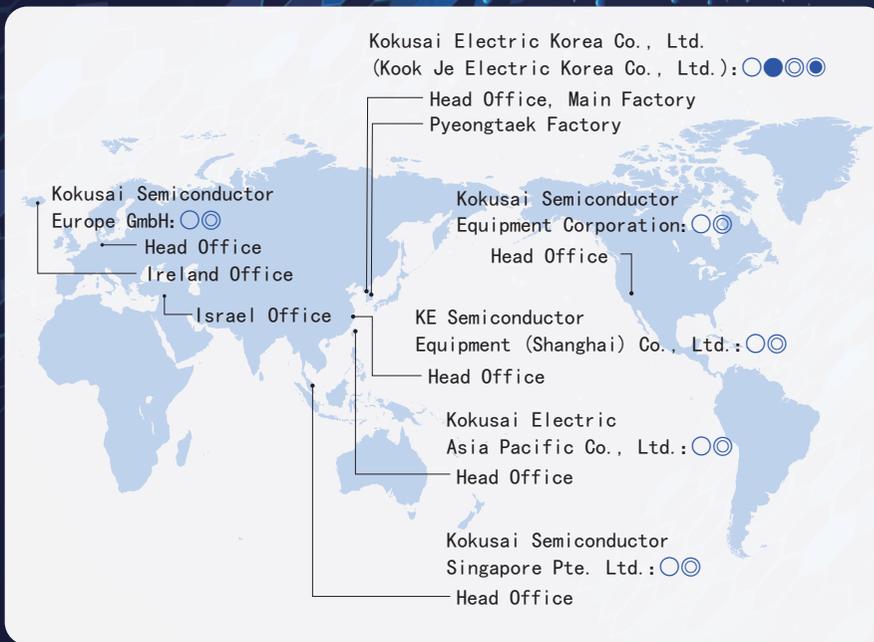
\* 截至2025年3月31日,本集团员工总数为2,540人。其中,海外员工比例为44.9%。



## 日本国内基地



## 海外基地



○集团总部、销售职能 ●生产职能 ○服务职能 ●研发职能

**富山事业所**  
位于遥望立山连峰的富山市八尾町。在专用的无尘室内研发、设计、生产支持下一代工艺的半导体制造设备等,满足全球大型用户对于最先进的高水平产品的需求。

**砺波事业所**  
2024年9月竣工的全新生产基地。通过引进IoT、DX等先进解决方案,推动向智能工厂转型。位于富山县砺波市,靠近现有的富山事业所,可高效共享供应链和工程师。

**KoKusai Electric Semiconductor Service Inc. 上市事业所**  
坐落在北阿尔卑斯山脉剑岳的山脚下,位于自然环境优美的富山县上市町,从事超声波清洗机、电阻率测量仪的研发、设计、生产以及面向半导体制造设备的控制器的生产,向全球用户提供产品。

**Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 天安总部/工厂**  
位于韩国首都首尔以南约100km处的忠清南道安市,从事半导体制造设备的设计、生产、改造,以韩国用户为中心提供产品。

**Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 平泽工厂**  
位于韩国首都首尔以南的京畿道平泽市。该工厂是面向韩国用户的服务基地,同时进行半导体制造设备的评估和研发,采用当地生产当地消费的方式,满足高水平的技术和产品需求。

# 通过技术与对话勇敢面对“课题”， 为半导体领域的发展和可持续发展的未来做出贡献

引导解决各种课题和问题，为世界各地的人们创造美好的未来

KOKUSAI ELECTRIC集团的业务是半导体制造设备的研发、设计、制造，以及零部件销售和维护服务等。20世纪50年代，本集团开始致力于研发半导体制造设备。自那时以来，技术取得了飞跃性发展，行业结构也发生了显著变化。1986年，我加入国际电气株式会社(当时的名称)。在当时的时代，日本将半导体销往全世界，成为现实意义上的“电子立国”。从那时起直至我就任社长的约40年间，行业所处的国际势力图发生了变化，KOKUSAI ELECTRIC集团的事业重心也转移到了海外。我的职业生涯的特点是，在上述背景下从事了各种各样的业务，包括设计、制造、营业、经营企划、海外派驻、集团公司经营等。作为集团高层，我的使命是利用在变化期间积累的经验，以灵活的视角引领半导体制造设备行业迈入新时代。

我们的指针就是企业口号“通过技术与对话，创造未来(Technology & Taiwa for Tomorrow)”。这句话看似简单，但我觉得它表达了企业活动的本质。将“技术”解释为“解决课题和问题的领导能力”，将“对话”解释为“课题和问题的发现能力”，以此将本集团培养的优势与所追求的未来联系起来。那么，“未来”是“对谁而言的”未来呢？对于这个问题，我首先想到的就是各位利益相关者。各位股东和投资者、商业合作伙伴、当地社区、员工及其家人。我认为它还涵盖了更广泛的人群。客户使用本集团的半导体制造设备来制造半导体器件，这些半导体器件又被组装到各种电子设备中，从而丰富人们的生活。为了实现这样的世界，我们将以“解决课题的能力”、“发现课题的能力”和“为世界各地的人们创造美好的未来”为关键词，在公司内外分享本集团的愿景。

董事长 社长兼执行董事

塚田 和徳



# 价值创造流程 >>

本集团在可持续发展经营的基础上,基于应解决的重要性课题,通过有效运用经营资本的业务和ESG措施两方面开展活动。我们将通过提供高质量、高性能的产品以及高附加值的服务,来实现一个有助于产业和社会发展、有助于构建可持续社会创造价值的目标。



## KOKUSAI ELECTRIC Way

**我们的使命**

**Purpose**  
通过技术与对话,创造未来

KOKUSAI ELECTRIC集团通过技术与对话,催生创新,成就未来。

**我们的目标**

**Vision**  
连接梦想与未来的最佳合作伙伴

**我们的价值观/行动**

**Value / Mission**

**我们的技术**

- 磨削技术
- 创新技术
- 以技术迎接挑战
- 展现技术的魅力

**我们的对话**

- 与先进技术的对话
- 与自然环境的对话
- 与社会课题的对话
- 与自身的对话

通过创造和革新为社会做贡献

创造可持续社会并保护地球环境

人才管理是创新创造的源泉

加强治理体系以实现可持续发展经营

尊重并关怀人权

**2024年度实绩**

**财务资本**

- 净资产 1,962 亿日元
- 自有资本比率 57.4%

**知识资本**

- 从事研发的人员 (日本国内) 429 人
- 专利价值增长潜力排名 (日经商务周刊) 第5名

**社会关系资本**

- 合作数量 (大学、外部机构、其他公司) 23 件
- 赞助数量(学会等) 19 件

**自然资本**

- 电力 56,681 MWh
- 燃油 (煤油、重油等) 259 kL
- 煤气(LPG、LNG) 195 t
- 城市煤气 56 km<sup>3</sup>
- 水(自来水、工业用水) 347 km<sup>3</sup>

**人力资本**

- 日本国内就业人员 1,373 人
- 海外就业人员 1,174 人

**生产资本**

- 全球网络 日本国内2家、海外6家,共计8家公司

**2024年度实绩**

19,473台	2,389 亿日元	24.2%
产品出货数量 (累计至2025年3月底)	销售额收益(合并) 比2023年度增长32% *2024年的WFE比2023年增长7%	调整后营业利润率
第1名(市场份额超过70%)	第1名(市场份额超过50%)	22.1%
批量ALD设备	Plasma Gate Modification Tools	ROE
ROIC		15.8%

**客户表彰** | 连续28年荣获Top 10 Customer Service奖项

**中期经营计划** (参考)作为前提的WFE市场规模:1,200亿美元以上

3,300 亿日元以上	75%左右	25%左右	30%以上
销售额收益(合并) 2023年度起平均年增长率(预测):16% *WFE的2023年至2027年的平均年增长率(预测)为5%	设备业务销售额 比例	服务业务销售额 比例	调整后 营业利润率
6%左右	25%以上	23%以上	
研发费用(相对于销售额收益的比例)	(参考)ROE	(参考)ROIC	

**2024年度实绩**

23,194t-CO <sub>2</sub>	1,173,395t-CO <sub>2</sub>	43%
Scope 1+2 GHG 排放量	Scope 3 GHG 排放量	废弃物产生量单耗改善率
100%	5.6%	68%
可持续采购检查表符合率	女性管理人员比例	育儿假取得率(男性)
100%	96次讲座	0人
育儿假取得率(女性)	e-Learning讲座数量	业务上的死亡人数
98%		98%
		董事会会议出席率
44小时	0件	AA
以开发员工能力和提升员工技能为目的的 每人培训时长	严重违法法律法规、罚款、罚金、 诉讼等的总件数	MSCI ESG评级

提供高性能、高附加值产品,扩大市场份额

与客户建立牢固的信任关系,提高客户满意度

提升本公司和产品的品牌价值,增强竞争优势

扩大重视环保性能的技术和产品的研发与应用

促进“对话/Tai-wa”,提高公司内部参与度

**KOKUSAI ELECTRIC Group 的未来图景**

进一步提高半导体器件质量

提升半导体器件制造商的品牌力和竞争力

半导体技术的进步,半导体产业的整体发展

致力于解决整条价值链上的环境和社会课题

激发组织和人才的活力,夯实创新基础

打造受社会信赖的廉洁企业和行业文化

**半导体发展带来的产业和社会发展**

- 搭载半导体的产品的高性能化和节能化
- 创造半导体产业的就业机会
- 通过普及IoT技术强化社会基础

**构建可持续社会**

- 降低环境影响
- 实现节能社会
- 解决人权课题
- 实现没有贫富差距的社会
- 与地域社区共生

## 本集团的CSR和可持续发展经营的思路

本集团认为,通过业务活动回应社会的信任和期望是企业的社会责任。

我们的可持续发展经营,在强烈意识到这份社会责任的基础上,从业务活动和ESG(解决环境与社会课题、强化治理)两方面追求经济价值和环境与社会价值,由此在助力达成SDGs的同时,努力兼顾可持续社会的实现和本集团的可持续发展。

本集团通过企业理念、重要性课题(重点考虑的课题)以及运营专业会议体、参加国际倡议等活动基础,推动可持续发展经营。

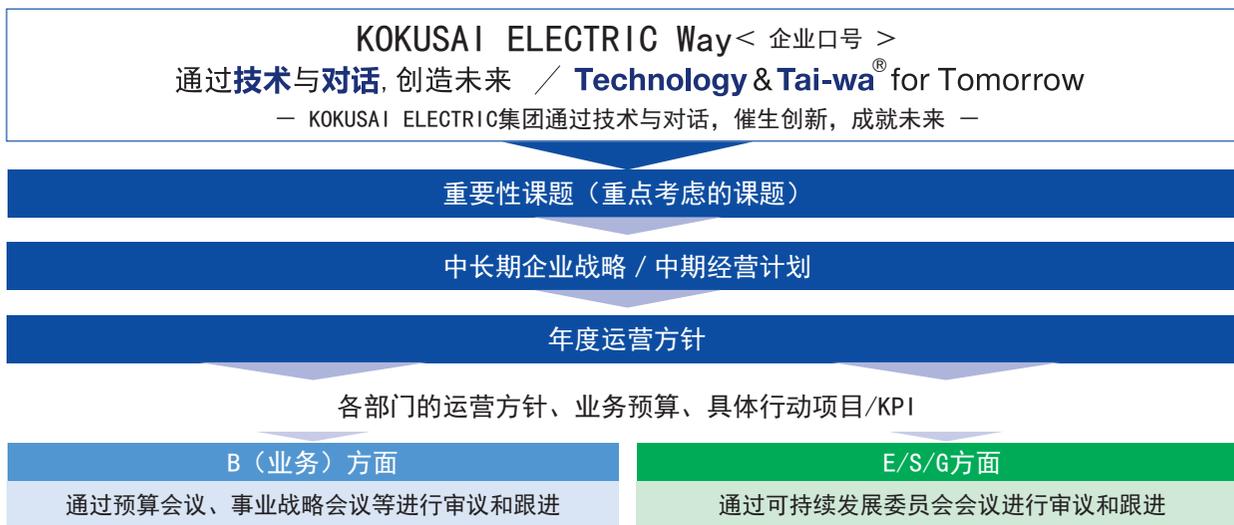
这些活动的实践状况将通过本报告书和网站等进行公布,作为与各位利益相关者就本集团的可持续发展经营展开广泛对话的材料。



### KOKUSAI ELECTRIC集团的理念体系

本集团秉持着KOKUSAI ELECTRIC Way理念,为了兼顾助力达成SDGs和本集团的可持续发展,确定了重要性课题作为要重点考虑的课题,从业务活动和ESG(解决环境与社会课题、强化治理)两方面出发,努力同时实现可持续社会和本集团的可持续发展。

本公司目前已确定了5个主要的重要性课题,并正在制定中长期企业战略和中期经营计划来解决这些课题。将这些计划作为具体措施和KPI纳入了各年度的运营方针和各部门的预算计划。最终,这些方针体现在每个人的业务中,有助于实现全公司的可持续发展经营。



# 中期经营计划

为了正确应对预想中的未来市场环境和客户需求,并推动向可提高收益的体质转变的措施,本集团设定了中长期企业战略和中期目标。有关中期目标的详细信息,请参照 [P.18](#) 财务负责董事的致辞。

## 行业前景的展望

半导体器件市场对半导体制造设备市场有重大影响,半导体器件的市场规模,相较于2016年的约3,500亿美元,2022年约为6,100亿美元,增至1.7倍。预计从2023年到2029年,将会以平均年增长率10.9%的速度增长\*1。使半导体器件市场规模扩大的背景有,智能手机和电脑等电子设备的需求上升,AI、IoT、DX等的推广促进数据中心扩充,绿色转型投资等面向产业的需求上升,以及主要国家推行产业支持政策。尽管全球经济近期呈现温和增长趋势,但前景依然不明朗,智能手机和电脑等电子设备的需求复苏缓慢。然而,在半导体器件市场,以生成AI普及等为背景,对先进DRAM的需求正在增加,期待从2025年起需求正式恢复,同时面向2029年,通过持续和加快技术革新,再次回到增长趋势。

半导体制造设备的市场规模,相较于2016年的约370亿美元,2022年约为980亿美元,增至2.6倍以上。预计从2023年到2029年,将会以平均年增长率7.6%的速度增长\*2。目前,对先进DRAM、面向先进节点的Logic/Foundry的设备投资正在加速,NAND也显示出到2025年将恢复的迹象。随着今后半导体器件需求的恢复,半导体制造设备的需求也有望恢复。从中长期来看,半导体器件正在向小型化、结构复杂化、三维化发展,在此背景下,对于能够同时实现高难度成膜和高生产效率的半导体制造设备的需求将会增长。

半导体器件 / 半导体制造设备的全球市场规模\*1,\*2(单位:十亿美元)

	2016年	2022年	2023年	2029年(预测)
半导体器件的全球市场规模	351.8	613.9	559.1	1,041.4
半导体制造设备的全球市场规模	37.0	97.7	99.0	153.7

\*1:Techinsights Inc. 2025-06-14 - Semiconductor Forecast Q2 2025 Update

\*2:Techinsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (Jun-2025)

\*3:本集团把采用循环提供多种气体的工序,在原子层级别上成膜的方法称为“ALD”。

\*4:出自:Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al. Published 21 April 2025 图表由Kokusai Electric根据Gartner的研究制作而成。此处列出的数值由Kokusai Electric计算得出。Treatment(膜质优化处理设备): RTP and Oxidation/Diffusion。GARTNER是Gartner Inc.或其关联公司在美国和其他国家(地区)的注册商标和服务标志,我们经该公司许可后使用。All rights reserved. Gartner不为Gartner研究出版物中的任何特定供应商、产品或服务背书。它并非旨在建议技术用户只选择获得最高评级或其他评级的供应商。Gartner Research出版物是发表Gartner Research的见解,并非表述事实,无论明示或暗示,包括本研究的商品性以及对于特定目的的适用性在内,Gartner概不负责。本书中记载的Gartner的内容(以下简称“Gartner内容”)作为Gartner财团订阅服务的一部分,是表述由Gartner, Inc.(以下简称“Gartner”)发行的研究观点或见解,并非表述事实。Gartner内容中的内容均为该Gartner内容发行时的内容,并非本书发行之日的内容。此外,Gartner内容中记载的见解可能会在未经预告的情况下发生变更。

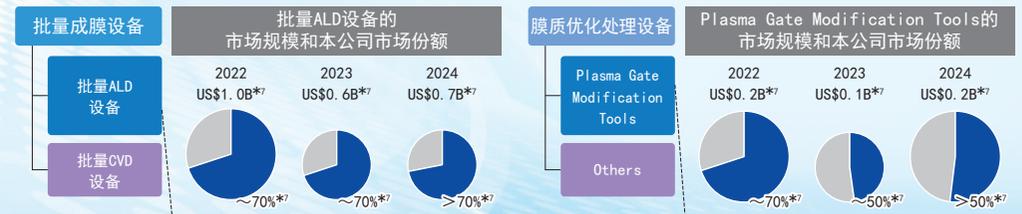
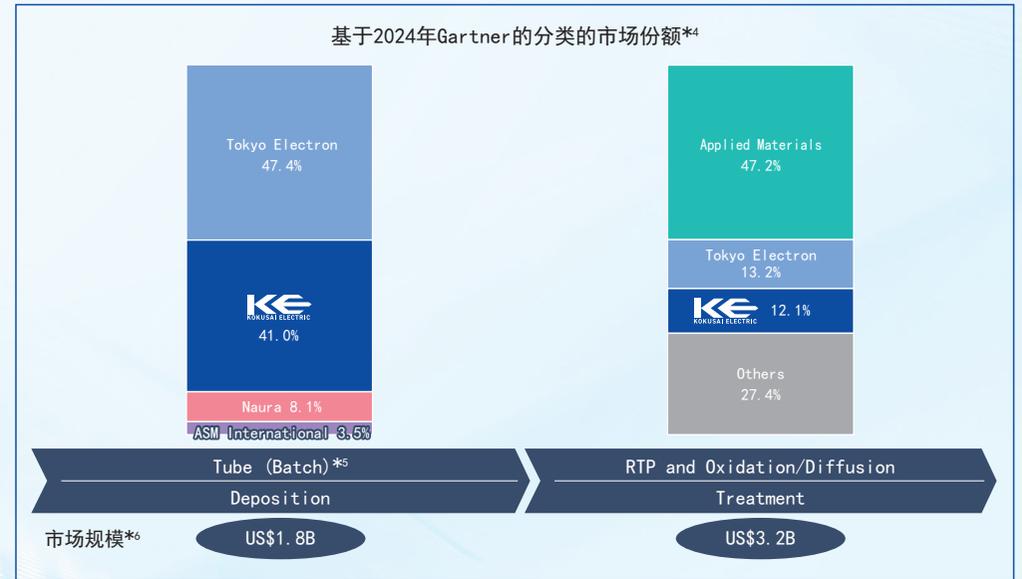
\*5:Gartner将WFE细分市场中的“Tube CVD”定义为“Tube (Batch)”(由本公司进行计算)

\*6:Gartner的各类别合计值

\*7:本公司根据公开信息和本公司销售额估算得出

## 市场份额的变化

半导体器件正在变得小型化、复杂化、三维化,在此背景下,需求将会不断扩大的批量ALD\*3设备和Plasma Gate Modification Tools在其领域中占据了全球最高市场份额(2024年)。\*4今后将继续努力通过提供高附加值产品来扩大市场份额、增加销售额收益并提高收益性。



## 中长期经营方针

本集团致力于半导体制造工艺前道工序中的“成膜”工序，凭借批量成膜设备、单片式膜质优化处理设备，拥有全球顶级市场占有率。近年来，由于半导体器件正在向小型化、结构复杂化、三维化发展，晶圆表面形状变得复杂，为了形成高质量薄膜等，必须具备更高水平的技术。对此，本集团将利用可同时实现高难度成膜和高生产效率的批量ALD\*1技术以及可在维持高生产效率的同时优化膜质的处理技术，致力于推动高附加值产品的销售拓展和研发，以期扩大业务规模。

此外，在设备的整个生命周期内，根据维护、维修、零部件供应、移机和改造等客户需求，丰富服务项目，同时，致力于扩充生产体制和研发体制，并利用DX提高生产效率，以此应对今后的需求增长。

在我们的ESG措施中，我们将基于以下五个重要性课题推进解决问题的活动：①通过创造和革新为社会做贡献、②创造可持续社会并保护地球环境、③人才管理是创新创造的源泉、④加强治理体系以实现可持续发展经营、⑤尊重并关怀人权

\*1:本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

## 具体措施

本集团所处的事业环境是，智能手机和电脑等电子设备的需求复苏缓慢，而半导体器件市场在生成AI普及等背景下，对先进DRAM的需求正在增加。在Logic/Foundry领域，尽管部分器件制造商减少投资，但从整体来看，面向先进节点的设备投资正在加速增长。在年度末，NAND也出现了恢复迹象，今后可望继续处于恢复态势。从中长期来看，智能手机和电脑等电子设备需求上升，AI、IoT、DX等推广促进数据中心扩充，以及绿色转型投资等，这些均预示着半导体相关市场将迎来显著增长。

鉴于此情况，本集团将根据上述经营方针，推行以下重点措施。

- 1 通过创新不断创造高附加值产品，同时强化研发体制，精准把握客户需求
- 2 加强向客户提供解决方案的能力，进一步提升业绩
- 3 进一步拓展服务业务
- 4 推动以集团一体化运营为首的高效经营
- 5 打造可以让多元化人才发挥积极作用的职场环境

## 中期企业战略

重点致力于3项战略，努力实现高于WFE(Wafer Fab Equipment:半导体制造设备市场)的事业成长。

- 1 随着NAND、DRAM、Logic/Foundry各应用的复杂化和三维化，本集团扩大销售批量ALD设备和膜质优化处理工艺设备
- 2 推动销售面向成熟节点的批量成膜设备和面向发展显著的SiC功率器件的设备，拓宽“成膜”领域的收益基础
- 3 在产品的整个生命周期内，提供可满足客户需求的服务，拓展高收益的服务业务

短期和中长期的催化剂和本集团的路线图



\*1 出自:TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)

## 事业战略

近年来,由于半导体器件结构正在向多层化、小型化、三维化发展,晶圆表面形状变得复杂,为了形成高质量薄膜,必须具备更高水平的成膜技术。此外,形状复杂的高质量成膜十分耗时,因此生产效率被希望进一步提升。对此,本集团将利用可同时实现高难度成膜和高生产效率的批量ALD\*1技术以及可在维持高生产效率的同时优化膜质的处理技术,致力于推动高附加值产品的销售拓展和研发,以期扩大事业规模。此外,在设备的整个生命周期内,根据维护、维修、零部件销售、移机和改造等客户需求,丰富售后服务项目,同时,致力于扩充生产体制和研发体制,并利用DX提高生产效率,以此应对今后的需求增长。

## 设备业务的概况

### 业务内容

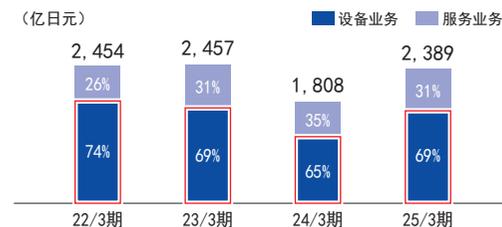
在半导体制造涉及的众多工艺中,设备业务负责生产和销售用于成膜工艺、膜质优化处理工艺、氧化·扩散·退火工艺的设备,这些工艺决定了半导体器件的性能。本集团的成膜工艺设备、膜质优化处理工艺设备受到了世界各地半导体器件制造商的高度评价,占据了全球最高市场份额。

### 成膜工艺设备

成膜工艺设备是在形成晶圆的电子电路时,形成多晶硅薄膜、绝缘膜等薄膜作为电路材料的设备,支持“ALD”、“LP-CVD”等。该成膜工序在形成晶圆上的电路时发挥着重要的作用,因此,对于使各设备提供高水平技术和高可靠性产品来说是必不可少的。作为本集团主力产品的批量成膜设备,受到全球半导体器件制造商的高度评价,其中,批量ALD设备拥有全球顶级市场占有率。

### 优势

- 采用批量ALD技术,同时实现高生产效率和高难度成膜
- 采用膜质优化处理技术,通过独有的等离子源,在高生产效率下实现了出色的各向同性和台阶覆盖性
- 凭借多年实绩,与客户建立了牢固关系



### 膜质优化处理工艺设备/氧化·扩散·退火工艺设备

膜质优化处理工艺设备旨在成膜后通过等离子体或加热除去薄膜内的杂质,或使粒子更加稳定。氧化·扩散·退火工艺设备适用于形成热氧化膜的工艺、成膜后加热来统一整张膜结晶尺寸的工艺(退火)、对成膜后注入的杂质进行加热使其均匀扩散的工艺。近年来,半导体器件变得小型化和复杂化,对膜质优化处理技术的需求也随之扩大,而我们的单片式膜质优化处理工艺设备占据了全球最高市场份额。

#### 小批量成膜工艺设备

“TSURUGI-C®剑”

- 具备支持下一代高难度成膜的性能和高生产效率的设备
- 支持最新的批量ALD技术等薄膜形成工艺



#### 大批量成膜工艺设备

“AdvancedAce®-II”

- 在高难度成膜的基础上实现以大批量方式增加处理数量、缩短处理时间的设备
- 支持批量ALD技术、批量CVD技术、氧化技术、扩散技术、退火技术等



#### 单片式膜质优化处理工艺设备

“MARORA®”

- 该设备旨在成膜后,通过等离子体或加热来改善膜质
- 对于复杂的半导体形状,可以进行高生产效率、高质量的膜质优化处理



#### 单片式退火工艺设备

“TANDUO®”

- 该设备旨在成膜后,通过加热来改善膜质
- 可在低温下进行退火

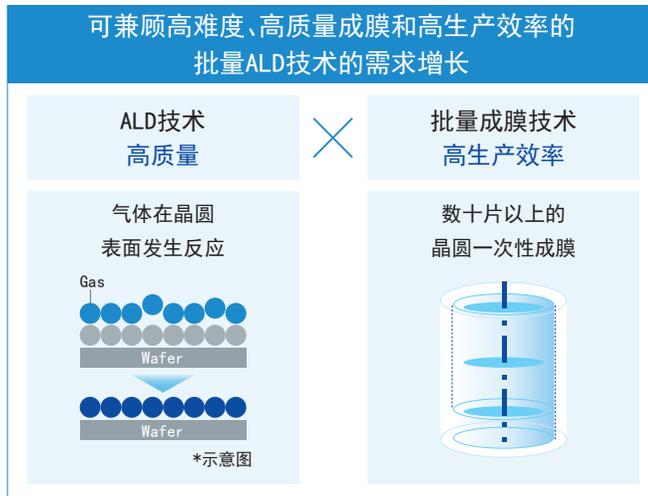
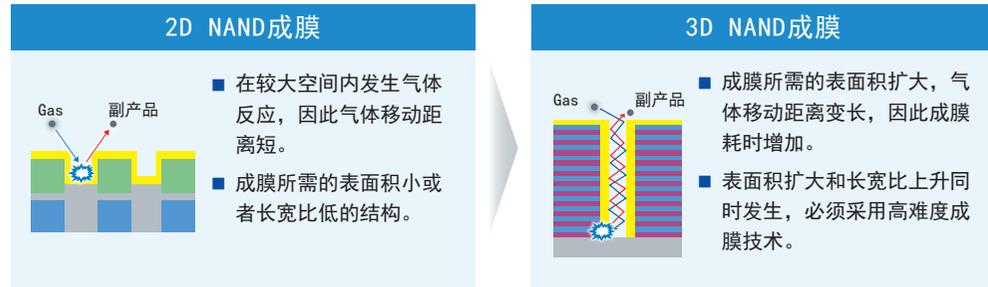


\*1 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

## 本集团的优势

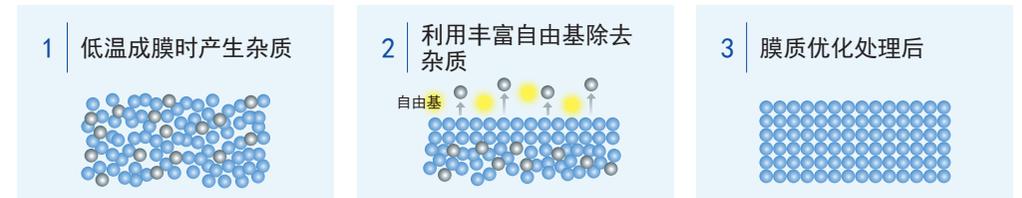
### 批量ALD\*1技术

ALD技术是一种高难度成膜技术,它可以形成台阶覆盖性好的高质量薄膜,在半导体器件发展的同时,对于该技术的需求也越来越高。该ALD技术循环供应多种气体并进行成膜,因此成膜十分耗时,在生产效率方面存在难题。对此,可对数十片以上晶圆进行一次性成膜的批量成膜技术具备较高的生产效率,是有效的解决方案。本集团的批量ALD技术结合了高质量成膜的ALD技术和对数十片以上晶圆一次性成膜的批量成膜技术,是非常合理的可以同时实现高生产效率和高质量成膜的解决方案。



### 膜质优化处理技术

所谓膜质优化处理技术,是指在成膜后通过等离子体或加热除去薄膜内的杂质,使粒子更加稳定,从而优化膜质的技术。随着半导体器件日益小型化和复杂化,低温环境下成膜的需求不断增长,处理技术作为可在低温环境中优化膜质的解决方案,需求也在扩大。本集团的处理工艺设备是通过独有的等离子体方式产生丰富自由基,高效地实现膜质优化,使其具有出色的各向同性和台阶覆盖性。



### TOPICS 批量ALD成膜设备的需求增长

随着半导体器件的多层化、小型化、三维化,需要在长宽比高和面积大表面上进行成膜。这提高了在复杂半导体器件结构上的成膜难度,耗费时间更长,从而导致生产效率下降。

解决此课题的方法是采用批量ALD成膜设备。批量ALD技术结合了在成膜的台阶覆盖性方面表现优异的ALD技术,以及对数十片以上晶圆一次性统一处理的批量技术。该技术同时实现了高难度成膜和高生产效率,因此,对于批量ALD成膜设备的需求在今后有望进一步增长。

器件复杂化推动 TAM增长

批量ALD市场 (USD 0.7bil)\*2

单片式ALD市场 (USD 3.3bil)\*2

批量ALD市场和单片式ALD市场与现状几乎没有重叠

\*1 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

\*2 本公司根据公开信息和本公司销售额收益估算得出

## 服务业务的概况

### 业务内容

服务业务是,为本集团制造和销售的半导体制造设备提供以零部件销售和维修服务为首的售后服务。此外,还从事设备移机和改造,以及晶圆尺寸200mm以下的传统设备(全新和二手)销售。

服务业务受半导体设备投资周期波动的影响较小,并且能够产生耗材销售等经常性收益,因此可望获取稳定、高利润的收益。今后也将秉持Design for Service Business\*的理念,努力提供高附加值服务。

\*1 其目的是在产品研发阶段确定服务事业的重要部分,并提前制作专利、设计权、以及用于防止本公司特有规格等遭到仿造的器件。

### 优势

- 不受市场波动影响的持续、稳定的业务
- 在客户基地附近建立了服务体制,快速准确地处理设备故障



### 面向功率器件的业务

服务业务还包括150mm和200mm设备的销售,其中面向功率器件的设备实现了高增长。目前,除中国以外,世界各国市场对面向功率器件的设备投资都处于停滞状态,但公司产品因操作和维护简便、备件通用化、节能加热器带来的优异环保性能等而广受欢迎,销售持续强劲。与客户共同实施评价的高温活化退火也首次获得POR,期待能随着未来市场复苏,为销售额增长做出贡献。

#### High-Temp Activation Anneal(新产品)

- 采用升至极高温的全新加热系统和150/200mm的通用平台
- 预计2025年起开始量产



### TOPICS 加强生产能力、研发能力

2024年10月,在富山县砺波市运营作为新工厂的砺波事业所的同时,现有的富山事业所将部分制造职能转移至砺波事业所,并扩充研发职能。由此,与2021年3月期相比,2026年3月期的制造容量将增至约2倍,研发能力将增至1.5倍。同时,构建了能够应对直至2031年3月期的需求增长的体制。



名称	砺波事业所
所在地	富山县砺波市下中条
占地面积	约40,000m <sup>2</sup>
投资金额	约240亿日元
用途/建设目的	制造半导体制造设备/提升生产能力以及强化现有的富山事业所的研发体制



名称	美国演示中心
所在地	美国俄勒冈州
占地面积	约34,000m <sup>2</sup>
投资金额	约200亿日元(预计)
用途/建设目的	半导体制造设备的演示评估和服务

半导体器件市场不仅有望在今后继续扩张,随着最先进半导体器件结构变得复杂化、三维化、小型化,越来越多的半导体器件制造商要求本集团通过演示评估等,为研发提供支持。

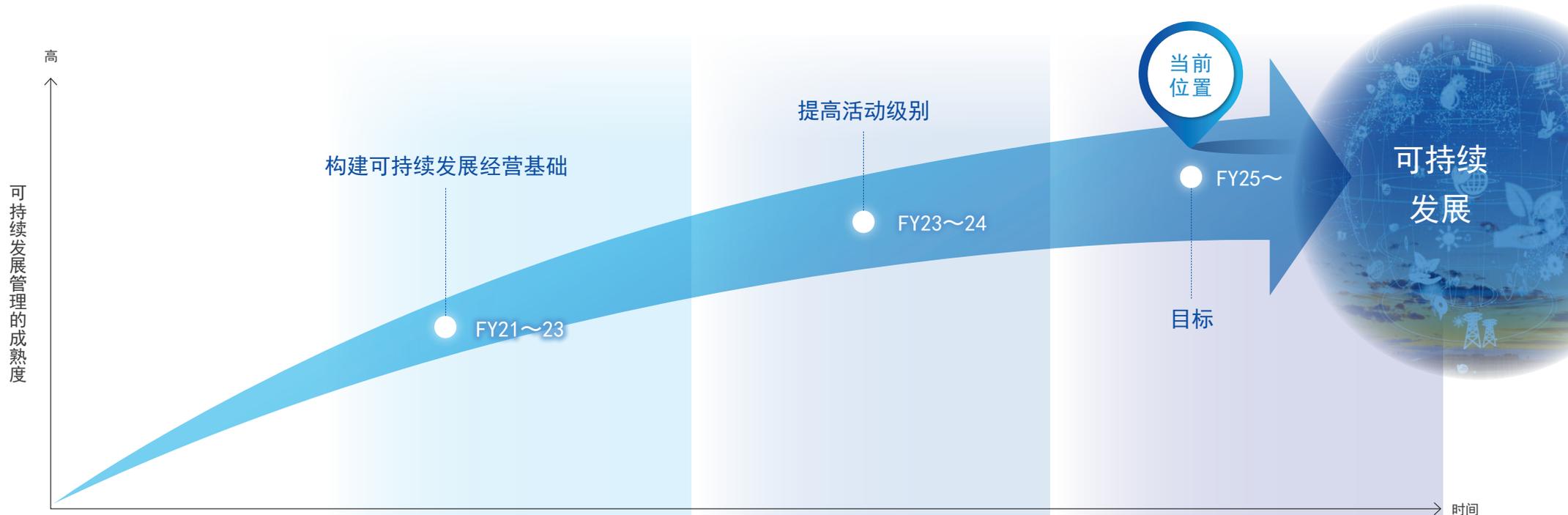
本集团根据客户要求,不断加强推动研发支援措施,包括扩大位于韩国的集团公司的演示评估区域等。作为措施的一环,还决定在美国俄勒冈州新设立美国演示中心(预计于2026年9月竣工)。

此前一直在富山事业所进行的面向美国半导体器件制造商的演示评估,如今将无需在日本和美国之间运送评估用晶圆和人员,即可快速完成。此外,强化本地支持体制可以准确把握客户面临的课题,从而并为客户的研发提供更细致的支持。为了应对未来的需求趋势,美国演示中心预计将会进行扩建,旨在进一步强化客户的研发支援体制和支持体制。

此外,2025年4月,在神奈川县横滨市开设了横滨技术中心,以此来加强下一代半导体相关要素技术研发。将在以成膜工艺为首的前道工艺中积累的技术和知识运用于硅中介层等中道工艺等,从而创造新的事业领域。

环境与社会课题解决措施的重要性和关注度不断提升,本集团根据以SDGs为首的日本国内外最新动向,为了构建用于实现实效性公司治理和企业可持续发展的“全球可持续发展治理”,描绘了目标和中长期路线图,在全公司推动相应措施。

对于各类措施,我们均同样重视“KOKUSAI ELECTRIC风格”,基于本集团的优势和应履行的使命,努力实践可持续发展经营,提升企业价值。



提升企业价值的路线图	可持续发展战略	制定企业口号和目的,确定重要性课题 (重点考虑的课题)	针对重要性课题采取措施, 确认进度,定期调整	实现企业口号和目的, 达成重要性课题KPI
	参与度战略	促进与各利益相关者的“对话/Tai-wa”,制定参与度方针		确立与各利益相关者的参与度
	披露可持续发展信息	掌握与ESG评估机构、信息披露指南等的 外部期待值之间的差距	纳入ESG Index	确立作为ESG优良企业的披露体制
		充实网站、综合报告书、公司治理报告书、 有价证券报告书等的信息披露		
可持续发展推进体制	构建和强化全球可持续发展治理体制 (设立和运用可持续发展委员会、向集团公司宣传各项活动等)		确立可持续发展推进体制	

## 5年内的主要财务数据

主要项目	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
销售额收益 (百万日元)	178,023	245,425	245,721	180,838	238,933
毛利 (百万日元)	75,951	107,069	100,805	74,965	101,743
毛利率 (%)	42.7	43.6	41.0	41.5	42.6
营业利润 (百万日元)	60,037	70,652	56,064	30,745	51,320
营业利润率 (%)	33.7	28.8	22.8	17.0	21.5
税前利润 (百万日元)	50,504	69,264	55,895	29,757	50,789
税前利润率 (%)	28.4	28.2	22.7	16.5	21.3
归属于母公司所有者的本期利润 (百万日元)	33,043	51,339	40,305	22,374	36,004
(参考)调整后营业利润(百万日元)	52,413	79,421	64,251	37,839	57,753
(参考)调整后本期利润(百万日元)	31,903	55,566	45,985	27,296	42,303
资本合计 (百万日元)	64,943	119,519	160,881	187,388	196,168
资产合计 (百万日元)	273,769	356,532	373,539	375,433	341,512
有息负债 (百万日元)	125,760	123,191	99,206	93,018	60,184
净现金 (百万日元)	△85,721	△14,792	6,847	△399	△15,429
研发费用 (百万日元)	7,552	9,885	12,425	12,683	15,604
设备投资金额 (百万日元)	2,562	3,322	6,568	20,454	20,348
折旧费和摊销费 (百万日元)	9,609	10,004	10,304	10,945	12,625
经营现金流 (百万日元)	51,127	73,615	29,993	2,942	38,477
投资现金流 (百万日元)	△3,312	△3,348	△7,825	△11,950	△27,706
财务现金流 (百万日元)	△48,317	△3,508	△25,113	△6,312	△58,106
自由现金流 (百万日元)	47,815	70,267	22,168	△9,008	10,771
每股属于母公司所有者的权益 (日元)	281.87	518.75	698.26	804.49	842.12
基本每股本期利润 (日元)	143.42	222.83	174.93	96.82	154.60
每股股息 (日元)	-	-	-	11.00	37.00
股息支付率 (%)	-	-	-	11.4	20.4
研发比例 (%)	4.2	4.0	5.1	7.0	6.5
自有资本比率 (%)	23.7	33.5	43.1	49.9	57.4
(参考)净资产收益率(ROE)(%)	47.3	60.2	32.8	15.7	22.1
(参考)投入资本回报率(ROIC)(%)	17.1	25.6	18.3	10.1	15.8

\* 本集团根据国际财务报告准则(IFRS)制作合并财务报表。

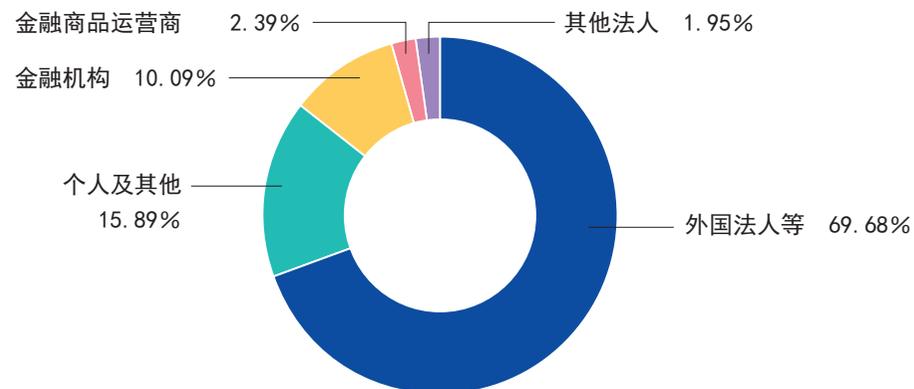
\* 关于每股股息和股息支付率,仅记载上市后的数据。关于2024年3月期的每股股息,考虑到上市时期是下半年的情况,采用半年的金额。

## 企业信息 / 股票状况

### 企业概况 / 股票相关信息 (截至2025年3月31日)

企业名称	株式会社KOKUSAI ELECTRIC
成立	2017年2月2日
集团总部所在地	〒101-0045 东京都千代田区神田锻冶町三丁目4番地 oak神田锻冶町5楼
资本金	140亿86百万日元
员工总数	合并:2,540人 / 单体:1,148人
上市市场	东京证券交易所 主要市场
证券代码	6525
可发行股本总数	900,000,000股
已发行股本总数	238,002,985股
财年	4月1日~次年3月31日
定期股东大会	每年6月
股东确定基准日期	3月31日
期末股息领取股东确定日期	3月31日
期中股息领取股东确定日期	9月30日
每手股数	100股

### 各所有者股份分布情况 (截至2025年3月31日)



### 大股东情况 (截至2025年3月31日)

股东名称	持有数(千股)	持股比例 (%)
KKR HKE INVESTMENT L.P.	42,505	18.25
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	35,080	15.06
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	17,673	7.59
日本Master Trust信托银行株式会社(信托账户)	16,331	7.01
KKR HKE Investment L.P. G.P. KKR HKE Investment Limited	12,187	5.23
Qatar Holding LLC	11,520	4.95
株式会社日本Custody银行(信托账户)	4,730	2.03
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	3,168	1.36
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	2,313	0.99
HSBC - FUND SERVICES CLIENTS A/C 500	1,942	0.83

通过**技术**与**对话**，创造未来



株式会社KOKUSAI ELECTRIC

<https://www.kokusai-electric.com/en>

发行月 2025年12月